



DKZ/53/2011

Warszawa, dnia 14.06.2011r.

Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami).

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
dostawę urządzenia do montażu wire bonder

słownik CPV 31700000-3

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej: 193 000,00 EUR.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Instytut Technologii Elektronowej
02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46

adres internetowy: <http://www.ite.waw.pl>

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ww. ustawy.

Oferty złożone w postępowaniu zostaną otwarte i ocenione przez Komisję Przetargową zgodnie z kryterium oceny ofert.

Spośród wszystkich, nie podlegających odrzuceniu ofert zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg kryterium oceny ofert.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia do montażu wire bonder, zwanego dalej „urządzeniem” wraz z instalacją, uruchomieniem i testowaniem.

Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia przedstawione są w załączniku nr 1 do siwz.

4. Składanie ofert częściowych i wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia - maksymalnie do 5 tygodni od daty podpisania umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7 siwz.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 7.1 Oświadczenie, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, [załącznik nr 2 do siwz];
- 7.2 Wykaz dostaw – wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 dostawy urządzeń do montażu wire bonder z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.

Zamawiający zaleca wypełnienie załącznika nr 3 do siwz.

Brak złożenia któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania.

8. Inne dokumenty wymagane od wykonawcy:

W przypadku przewidywanego podwykonawstwa, zamawiający żąda wskazania w ofercie tych części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Brak złożenia informacji w przedmiocie podwykonawstwa uznaje się za zamiar wykonania zamówienia przez Wykonawcę samodzielnie.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Oświadczenia i wnioski mogą być przekazywane wyłącznie drogą pisemną, natomiast wszelkie zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr Michał Urbański e-mail urbanski@ite.waw.pl

Pisemną korespondencję do zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Instytut Technologii Elektronowej
Al. Lotników 32/46,
02-668 Warszawa.
Zespół Zamówień Publicznych
Budynek VI, pokój nr 216.

Fax: + 48 22 548 78 46

10. Wymagania dotyczące wadium: nie wymagamy.

11. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi : 30 dni od daty składania ofert.

12. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę należy złożyć na piśmie.

Oferta musi zawierać:

- a) dokładną nazwę i adres oferenta,
- b) datę sporządzenia oferty,
- c) wypełniony załącznik nr 1 do siwz,
- d) cenę netto w PLN (dopuszcza się podanie ceny w EUR, USD lub GBP. W przypadku złożenia ofert w EUR, USD lub GBP dla porównania cen ofert zastosowany zostanie przelicznik na złote polskie – PLN. Przelicznik ten będzie zgodny z kursem sprzedaży walut NBP jaki będzie obowiązywał w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert).

Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.

Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w punkcie 7 niniejszej siwz.

Zamawiający zaleca wypełnienie FORMULARZA OFERTOWEGO - załącznik nr 4 do siwz.

W przypadku udziału w postępowaniu firm spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się złożenie oferty, a także dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji w języku polskim lub w języku angielskim.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia **01.07.2011r.** do godziny **10:00** (w dni robocze w godz. 9:00÷14:00) w siedzibie zamawiającego w Warszawie, Al. Lotników 32/46, bud VI pokój nr 216. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.07.2011r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Warszawie, Al. Lotników 32/46 w budynku VI pokój nr 216.

Ofertę należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia opakowania (np. w zaklejonej kopercie). Na kopercie lub opakowaniu powinna być umieszczona nazwa i adres firmy składającej ofertę, a także powinien znajdować się napis: Instytut Technologii Elektronowej, Al. Lotników 32/46, 02 – 668 Warszawa. Budynek VI, pokój 216. Oferta w przetargu nieograniczonym na „dostawę urządzenia do montażu wire bonder” – nie otwierać do dnia 01.07.2011r. do godz. 10:15.

14. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena netto podana w PLN (EUR, USD lub GBP) musi obejmować:

- a) urządzenie zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do siwz,
- b) instalację,
- c) uruchomienie,
- d) testowanie,
- e) transport, rozładunek i posadowienie,
- f) warunki dostawy: DDP Warszawa,
- g) ubezpieczenie,
- h) szkolenie osób zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz w punkcie 23.

17.2 Gwarancja:

- 1) Dostawca gwarantuje prawidłowe działanie i jakość techniczną dostarczonego przedmiotu umowy w ciągu (okres gwarancji w ofercie) miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego, lecz nie dłużej niż (okres gwarancji w ofercie) + 3 miesiące od daty dostawy.
- 2) Dostawca w ramach gwarancji pokrywa koszty naprawy lub wymiany wadliwego towaru, jak również pokrywa koszty związane z jego transportem.
- 3) W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Kupującego, Dostawca ma obowiązek zrealizować naprawę lub wymianę nie później niż w okresie 7 tygodni od daty pisemnego zgłoszenia usterek.
- 4) Gwarancja zostanie przedłużona o czas ewentualnej naprawy przedmiotu umowy.
- 5) Wymienione lub naprawione części zostaną objęte gwarancją Dostawcy lub Producenta.
- 6) W okresie gwarancji, Dostawca gwarantuje czas reakcji serwisu maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia usterek.

17.3 Instrukcja dostawy:

- 1) Przedmiot umowy będzie wysłany na poniższy adres i pozostawiony do dyspozycji Kupującego.

Adres dostawy: Instytut Technologii Elektronowej
 Al. Lotników 32/46
 02-668 Warszawa

- 2) Dostawca zawiadomi Kupującego faksem o wysyłce (Nr +48 22 54-87-803).
- 3) Dostawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy deklarację zgodności CE urządzenia.

17.4 Warunki płatności:

Płatność zostanie dokonana w następujący sposób:

- 1) 80% wartości umowy – (wartość z oferty) – płatne przekazem bankowym na podstawie oryginału faktury i dokumentów przewozowych na konto Dostawcy w ciągu 14 dni od daty wysłania przedmiotu umowy.
- 2) 20% wartości umowy – (wartość z oferty) – płatne przekazem bankowym na podstawie oryginału faktury na konto Dostawcy w ciągu 14 dni od daty podpisania przez obie strony Umowy protokołu odbioru.

Kupujący zapłaci Dostawcy przekazem bankowym kwotę za przedmiot umowy na konto Dostawcy w:

.....

Koszty bankowe na terenie Polski ponosi Kupujący, a poza jej granicami – Dostawca.

17.5 Odbiór przedmiotu umowy:

Uruchomienie urządzenia obejmuje rozruch techniczny oraz wykonanie testów funkcjonalnych potwierdzających jego parametry techniczne zgodnie ze specyfikacją techniczną i wymaganiami określonymi w siwz. Potwierdzenie odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi poprzez podpisanie przez obie strony protokołu odbioru.

17.6 Siła wyższa:

1. W przypadku działania siły wyższej strony Umowy są zwolnione od odpowiedzialności za nie wywiązanie się ze swoich zobowiązań lub zobowiązania te będą zmienione, zgodnie z zapisem punktu 4. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszystkie wydarzenia, nie dające się przewidzieć przez żadną ze stron w dniu podpisania Umowy i występujących po tej dacie, nie dających się uniknąć i pozostających poza kontrolą obydwu stron.

- Przypadkami siły wyższej są np. wypadki, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, wybuch, wojna, mobilizacja, strajki, blokady, generalny brak środków transportu, materiałów lub siły roboczej.
- Strona Umowy chcąc zgłosić roszczenia wynikające z siły wyższej ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę o jej wystąpieniu i zakończeniu.
- Strona zgłaszająca roszczenia musi udowodnić drugiej stronie wystąpienie siły wyższej przy pomocy dokumentów wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego władze w swoim kraju. Daty i terminy wypełnienia zobowiązań zostaną przełożone lub przedłużone o okres, w którym zaistniała siła wyższa.

17.7 Rozstrzygnięcie sporów:

Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, których nie da się wyjaśnić polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z regulaminem tego Sądu.

18. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy: nie wymagamy.

19. Tryb udzielania wyjaśnień na temat siwz:

W terminie do dnia 22.06.2011r. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. Zamawiający odpowie na wszystkie zapytania, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający zamieści treść pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (dostęp do powyższych informacji - strona internetowa www.uzp.gov.pl).

21. Inne:

Do spraw nieuregulowanych w siwz mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Technicznych

mgr Michał Urbański

Zamówienie jest finansowane ze środków wspólnotowych: zakup jest finansowany z projektu nr POIG 02.01.00-14-081/09 pt. Mikrosystemy i NanoTechnologie Elektroniczne dla Innowacyjnej Gospodarki „MINTE”

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do montażu wire bonder.

Lp.	Nazwa parametru	Wymaganie	Kolumna do wypełnienia przez oferenta *
1	2	3	4
1.	Typ urządzenia		podać
2.	Rok produkcji	2011	potwierdzić
3.	Kraj producenta urządzenia		podać
4.	Producent urządzenia		podać
5.	Urządzenie	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych.	potwierdzić
6.	Wymagania ogólne	Urządzenie przeznaczone jest do programowalnego, kontrolowanego i powtarzalnego wykonywania połączeń drutowych pomiędzy przyrządami półprzewodnikowymi, ceramicznymi i metalowymi elementami obudów itp. Urządzenie powinno dać się postawić na stole laboratoryjnym.	potwierdzić
7.	Rodzaje procesów	1. Wykonywanie połączeń drutowych <ul style="list-style-type: none"> - Metody: ultrakompresja i termokompresja - Połączenia typu: kulka-klin, klin-klin, kulka-klin ze wzmocnieniem. - Dołączanie kulek, dołączanie kulek z odcinkiem drutu, wykonywanie połączeń klinowych taśmą do 25x250µm, wykonywanie połączeń klinowych w głębokich wnękach. 2. Programowalne, niszczące i nie niszczące pomiary wytrzymałości połączeń (metody: zrywanie i ścinanie), rejestracja wyników	potwierdzić
8.	Parametry urządzenia	Urządzenie pozwala wykonywać ręcznie, półautomatycznie i automatycznie połączenia zarówno kulkowo oraz klinowo	potwierdzić
		Z przesuwem w osiach X,Y,Z, sterowanym komputerowo, minimalny zakres ruchu X-Y: 100x100 mm	potwierdzić
		Wyposażone w monitor LCD min. 17cali do podglądu pola roboczego podczas pracy.	potwierdzić
		Zakres ruchu w osi Z, min. 60 mm	potwierdzić
		Rozdzielczość przesuwu w osiach X, Y lepsza niż 0,3µm.	potwierdzić i podać
		Powtarzalność przesuwu w osiach X, Y lepsza niż 3µm.	potwierdzić i podać
		Programowana prędkość ruchu w osiach X, Y	potwierdzić i podać

9.	Głowica do wykonywania połączeń kulkowych <i>ball bond</i>	Wykonywanie połączeń drutami o średnicy z zakresu co najmniej 17,5µm – 50µm.	potwierdzić i podać
		Oświetlenie pola roboczego głowicy,	potwierdzić i podać rodzaj
		Kamera CCD zapewniająca podgląd podczas pracy.	potwierdzić
		Wyposażona w zestawy narzędzi (kapilary) i drutów Au dla średnic 25 oraz 38 µm do połączeń i do dołączania kulek (2 zestawy)	potwierdzić i podać
10.	Głowica do wykonywania połączeń klinowych <i>wedge bond</i>	Wykonywanie połączeń drutami o średnicy z zakresu co najmniej 18µm – 75µm i taśmą do 25 x 250 µm, w głębokich wnękach	potwierdzić i podać
		Oświetlenie pola roboczego głowicy,	potwierdzić i podać rodzaj
		Kamera CCD zapewniająca podgląd podczas pracy.	potwierdzić
		Wyposażona w zestawy narzędzi (sonotrod) i drutów Au i Al dla średnic 25 oraz 38 µm do połączeń klinowych oraz w zestaw narzędzi i materiałów do połączeń taśmą złotą - wymiar taśmy 20 x 125 µm. (5 zestawów łącznie)	potwierdzić i podać
11.	Głowica do zrywania połączeń	Zakres pomiaru min.1 N, rozdzielczość min. 6µN, dokładność co najmniej +/- 2,5 mN, programowana szybkość zrywania	potwierdzić i podać
		Wyposażona w zestaw narzędzi do zrywania połączeń taśmą i drutem	potwierdzić
12.	Głowica do ścinania połączeń	Zakres pomiaru min. 5 N, rozdzielczość co najmniej 30 µN, dokładność: min. +/- 2,5mN, programowana szybkość zrywania	potwierdzić i podać
		Wyposażona w zestaw narzędzi do ścinania połączeń kulkowych	potwierdzić
13.	Oświetlenie stolika regulowane	Zapewnione.	potwierdzić
14.	Podgrzewany stolik dla podłoży i obudów, z mechanicznym i próżniowym mocowaniem	Co najmniej dla podłoży 4"x4".	potwierdzić
		Regulacja temperatury co najmniej do 200 ⁰ C.	potwierdzić
		Cyfrowy kontroler temperatury stolika, rozdzielczość 1 ⁰ C.	potwierdzić
14a	Opcja	Mocowanie obudów TO5,TO8,TO18	potwierdzić i podać
15.	Generator ultradźwięków PLL	Zapewnione.	potwierdzić
16.	Automatyczna kontrola i pomiar deformacji połączeń	Zapewnione.	potwierdzić
17.	Projektowanie kształtu połączenia (pętli) drutowego	Zapewnione.	potwierdzić
18.	Kontrola optyczna (mikroskop) podczas pracy	Zapewnione.	potwierdzić

19.	Oprogramowanie do rozpoznawania obrazu	Wspomagające automatyzację procesu wykonywania połączeń	potwierdzić i podać
20.	Sposób sterowania	Sterowanie komputerowe z dedykowanym oprogramowaniem opartym na systemie Windows, (XP Pro lub 7 Pro) , gniazdo USB	potwierdzić
21.	Dwuetapowy test akceptacyjny: a) Wstępny test akceptacyjny w siedzibie Wykonawcy b) Końcowy test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego	Wykonanie testów na standardowych podłożach stosowanych przez wykonawcę urządzenia. Wykonanie połączeń drutowych aluminiowych oraz złotych typu <i>ball bond</i> oraz <i>wedge bond</i> pomiędzy: - obudową a przyrządami półprzewodnikowymi (czujniki, detektory). - przyrządami półprzewodnikowymi - obudowami i polami montażowymi Sprawdzenie automatycznej kontroli i pomiaru deformacji połączeń. Sprawdzenie możliwości modelowania kształtu połączeń drutowych. Wykonywanie co najmniej 10 połączeń drutowych w każdym z wymienionych wyżej przypadków. (struktury testowe zapewnia zamawiający)	potwierdzić
22.	Termin realizacji przedmiotu zamówienia	Maksymalnie do 5 tygodni od daty podpisania umowy	potwierdzić i podać
23.	Szkolenie trzech osób w siedzibie Zamawiającego	Zapewnione.	potwierdzić
24.	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim	Zapewnione.	potwierdzić i podać
25.	Dostępność części zamiennych - 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru	Zapewnione.	potwierdzić
26.	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru	Zapewnione.	potwierdzić
27.	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru	Zapewnione.	potwierdzić
28.	Okres gwarancji - minimalnie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru	Zapewnione.	podać

* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.

.....
pieczęć adresowa Wykonawcy

.....
data

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu.

.....
podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

.....
pieczęć adresowa wykonawcy

.....
data

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do montażu wire bonder oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy następujące dostawy:

Lp.	Przedmiot dostawy	Wartość dostawy	Data wykonania dostawy	Odbiorca dostawy
1	2	3	4	5
1.				
2.				

Uwaga! Do każdej przedstawionej w tabeli wykonanej dostawy należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

.....
pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

dla Instytutu Technologii Elektronowej

Przedmiot zamówienia		Dostawa urządzenia do montażu wire bonder.
1.	Nazwa i adres Wykonawcy	
2.	NIP	
3.	Telefon: Fax: e-mail:	
4.	Cena oferty netto PLN (EUR/ USD/ GBP)
		słownie:.....
	Stawka podatku VAT%
5.	Termin wykonania zamówienia: do 5 tygodni od daty podpisania umowy	Podać w tygodniach:
6.	Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy	
7.	Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia do montażu wire bonder oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z siwz.	
8.	Dokumenty załączone do oferty	1. : :
9.	Miejscowość Data sporządzenia oferty	

.....
podpis osoby /osób uprawnionej /uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy